

【景美科技 SEMICON Taiwan 2026 新聞稿】

景美科技 (7899) 鎖定 AI 測試介面商機 三大產品線同步升級 下半年延續逐季成長態勢為營運目標 高階探針卡需求驅動結構件價值提升

2026 年 9 月 1 日 / 台北

SEMICON Taiwan 2026 國際半導體展於 9 月 2 日至 4 日在台北南港展覽館一、二館舉行。先進製程測試介面結構件供應商 景美科技 (7899) 以「上下導板細微鑽孔、探針卡結構組件、ATE Stiffener 測試機框」三大核心產品線參與此次產業盛會，展出對應 AI 與高效能運算 (HPC) 晶片測試需求的高精度關鍵結構件，景美科技攤位在一館一樓 K 區，號碼 K3183。

● 產品為核心 三大探針卡產品線合計占營收 85%

- **上下導板細微鑽孔 (Upper / Lower Plate)**：占上半年營收 26%。於陶瓷或工程塑膠基板加工出引導探針對位的細微孔位，孔徑、孔距與板厚公差直接決定探針卡的對位精度與良率，屬公司技術門檻最高的產品。以孔數計價，針數與孔位密度越高，單片加工價值越高。
- **探針卡結構組件 (Spacer、JIG、Backer 等)**：占上半年營收 48%，為公司最大宗產品線。以高精度組裝工藝控制公差累積，確保探針卡模組在反覆接觸、高溫測試環境下維持結構穩定與可靠度。
- **ATE Stiffener 測試機框**：占上半年營收 11%。公司於 2025 年第四季通過晶圓代工廠驗證、正式切入日系測試機框供應，並自 2026 年第一季起穩定出貨。

三大探針卡相關產品線合計占上半年營收 85%。景美科技同時具備高強度合金金屬材料、高性能工程塑膠與複合材料的整合加工實力，可依客戶需求提供少量多樣、高度客製化的彈性製造。

景美科技發言人 鄭雅文 表示，公司的成長並非依賴單一產品線拉抬。隨 AI 與 HPC 晶片訊號接點密度提高、單卡針數與孔位密度同步上升，導板細微鑽孔、精密結構件加工與整合 ATE Stiffener 測試機框三大能力均同步出現需求成長，三條產品線並進，是今年營運動能的來源。

● 高階探針卡市場：AI 驅動結構性成長 2029 年上看近 40 億美元

探針卡為晶圓測試 (CP) 階段連接測試機台與晶片的關鍵介面。依市場研究機構 TechInsights 與 Yole 統計及預估，全球探針卡市場規模 2025 年約 27 億美元，2024 年至 2029 年年複合成長率接近 8.9%，2029 年可望成長至近 40 億美元。

技術路線上，隨先進製程節點微縮，探針卡由早期懸臂式 (Cantilever) 轉向垂直式 (VPC) 與微機電 (MEMS) 架構，多家市場研究機構均指出此兩類為現階段主要成長來源；景美科技的結構件產品同時支援垂直式與 MEMS 兩種架構的探針卡。

需求端的關鍵驅動來自 AI 晶片測試複雜度提升。GPU、AI ASIC 與高頻寬記憶體 (HBM) 屬高腳數、高複雜度元件，測試量與頻率同步放大；chiplet、2.5D / 3D 與 HBM 堆疊等先進封裝流程導

入「已知良品裸晶 (Known Good Die) 」機制，為確保封裝前良率，測試強度前移至晶圓階段。規格上，先進製程節點的單卡針數常超過 10,000 針，探針間距則朝 40 微米以下發展，對導板孔位密度、對位精度與結構穩定性的要求同步拉高。

就供應鏈分工而言，一張探針卡由上而下依序為測試機框 (Stiffener) 、印刷電路板、空間轉換器 (Space Transformer) 、導板 (Guide Plate) 與探針。國際探針卡大廠多將資本優先投入探針針體、電路板與多層載板等核心環節，並將高精度結構件與細微加工委由專業供應商承接。景美科技即位居導板細微鑽孔與結構件製造節點，客戶涵蓋全球最大晶圓代工廠、歐美日韓探針卡廠及台灣前三大探針卡廠，形成一源多客的供應結構；全球探針卡市場高度集中，多家市場研究機構佔前五大廠合計市占逾六成。

景美科技技術長 何震宏表示，AI 與 HPC 晶片快速發展，訊號接點密度與測試針數持續提升，帶動單張探針卡對導板孔數與結構精度的需求同步升級；由於細微鑽孔以孔數計價，針數越高、孔位越密集，對應加工價值亦隨之提高，形成具延續性的結構性成長動能。公司上半年營收已逐季墊高；展望下半年，AI 晶片測試需求延續，既有客戶專案亦陸續進入量產階段，**公司以延續逐季成長態勢為營運目標**。景美科技將持續聚焦高精度製程能力升級與高毛利產品比重提升，以技術領先、品質穩定與量產交付三大優勢，朝全球先進製程測試介面關鍵結構件供應商的目標穩健邁進。

景美科技 2026 年上半年產品組合 單位：%

產品線	2026 上半年
探針卡結構組件	48%
探針卡細微鑽孔	26%
探針卡機框 (ATE Stiffener)	11%
三大探針卡產品線合計	85%

新聞發言人：品牌 總經理 鄭雅文 winwin_cheng@cmat-tek.com.tw 0933-888-334

公司簡介：

半導體先進製程測試介面 關鍵結構件供應商 景美科技股份有限公司 (7899.TW) 於 2026 年 2 月 25 日正式登錄興櫃交易。公司成立於 2006 年，專注於半導體先進製程探針卡細微鑽孔與結構件之設計、製造與銷售，實收資本額約新台幣 2.29 億元。景美科技深耕探針卡結構件近 20 年，客戶涵蓋全球最大晶圓代工廠、歐美日韓探針卡廠及台灣前三大探針卡廠，產品包含晶圓測試 (CP) 用垂直式探針卡 (VPC) 與微機電探針卡 (MEMS) 之關鍵結構件，核心產品涵蓋上下導板細微鑽孔 (Upper Plate / Lower Plate) 、ATE Stiffener、Spacer、JIG、Backer 等高精度、高門檻關鍵結構件，為高階晶片測試不可或缺的重要組成。

景美科技之競爭優勢包括：1. 具備完整之探針卡結構件設計與開發能力。2. 兼具高強度合金金屬材料、高性能工程塑膠與複合材料之整合實力。3. 以高精度組裝工藝有效控制公差累積，確保模組功能性與高度可靠性。4. 具備少量多樣高客製化的彈性製造能力。5. 以夥伴思維深度融入客戶供應鏈，建立互補協作模式並加速產品認證。